

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2022-024

北京赛微电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 733,289,072.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	耐威科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	
传真	010-59702066	010-59702066	
电话	010-82252103	010-82251527	
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路晶圆代工生产商，也是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业晶圆制造商。公司在国内外拥有多座中试平台及量产工厂，业务遍及全球，服务客户包括国际知名的DNA/RNA 测序仪、光刻机、计算机网络及系统、硅光子、红外、可穿戴设备、新型医疗设备、汽车电子等巨头厂商以及细分行业的领先企业，涉及产品范围覆盖了通讯、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多领域。公司同时正在打造先进的晶圆级封装测试能力，致力于为客户提供从工艺开发、晶圆制造到封装测试的系统化高端制造服务，努力发展成一家国际化经营的知名半导体制造领军企业。

报告期内，公司从事的主要业务包括MEMS工艺开发及晶圆制造、GaN外延材料生长及芯片设计，以及因剥离未完成而被动延续的部分原有业务；与此同时，公司围绕半导体主业开展产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。

报告期内，为公司贡献业绩的具体业务主要为MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造。

（一）MEMS业务

公司现有MEMS业务包括工艺开发和晶圆制造两大类：

公司MEMS工艺开发业务是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程。

公司MEMS晶圆制造业务是指在完成MEMS芯片的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供批量晶圆制造服务。

MEMS是指利用半导体生产工艺构造的集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器、通讯接口和电源等部件于一体的微米至毫米尺寸的微型器件或系统；MEMS将电子系统与周围环境有机结合在一起，微传感器接收运动、光、热、声、磁等信号，信号再被转换成电子系统能够识别、处理的电信号，部分MEMS器件可通过微执行器实现对外部介质的操作功能。

（二）GaN业务

公司现有GaN业务包括外延材料和芯片设计两个环节：

公司GaN外延材料业务是指基于自主掌握的工艺诀窍，根据既定技术参数或客户指定参数，通过MOCVD设备生长并对外销售6-8英寸GaN外延材料。

公司GaN芯片设计业务是指基于技术积累设计开发GaN功率及微波芯片，向下游客户销售并提供相关应用方案。

GaN是第三代半导体材料及器件的一个类别，因其禁带宽度(Eg)大于或等于2.3电子伏特(eV)，又被称为宽禁带半导体材料，与第一、二代半导体材料硅(Si)和砷化镓(GaAs)相比，第三代半导体材料及器件具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子速率等优点，可以满足现代电子技术对高温、高功率、高压、高频以及抗辐射等恶劣条件的新要求。

报告期内，公司仍阶段性开展原有导航业务，包括惯性导航系统和卫星导航板卡两大类。

二、集成电路及细分行业整体发展情况

2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4,519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2,763亿元，同比增长10.1%。

（一）MEMS行业

全球传感器行业市场规模达数千亿美元，而基于MEMS工艺批量生产的传感器件凭借其功耗低、体积小、性能出色等特

点可以在各个行业和领域应用并逐步对传统传感器进行替代。预计未来随着MEMS产品应用领域的不断延伸，其市场规模将迅速扩大。在移动终端上，硅麦克风、惯性传感器已被广泛采用，且耗用量仍在不断上升；另外，随着MEMS产品在医疗设备、工业设备、汽车电子、消费类电子等领域应用的推广和普及，市场对超声、压力、微针、芯片实验室、红外、硅光子、射频前端、振镜、超声波换能、气体等MEMS器件的需求也在迅速提升；此外，物联网、可穿戴等创新设备对器件形态便捷化、微型化需求也将成为推动MEMS发展的新力量。

MEMS器件目前被广泛应用于消费电子、汽车电子、工业与通讯、生物与医疗等行业。受益于5G通信、人工智能、移动互联网（智慧城市、智慧医疗、智慧安防）、光电通信、自动工业控制等市场的高速成长，MEMS行业发展势头强劲。根据Yole Development的研究预测，全球MEMS行业市场规模将从2020年的121亿美元增长至2026年的约182亿美元，CAGR达7.2%，通讯、生物医药、工业汽车及消费电子的应用增速均非常可观，其中通讯领域的增长率最高。预计到2026年，10亿美元以上的MEMS细分领域包括射频MEMS（40.49亿美元）、MEMS惯性器件（40.02亿美元）、压力MEMS（23.62亿美元）、麦克风（18.71亿美元）以及未来应用（13.63亿美元）。

（二）GaN行业：

近年来，随着物联网、云计算、人工智能、新能源汽车等领域的高速发展，对电能的消耗急剧增加，要求功率电子系统具有更高的能量转换效率以及更小的体积；同时，随着5G通信时代的来临，要求更快的数据传输速度、更低的传输延迟、更高的数据密度和增强高速应用等。而GaN由于具有特殊的材料压电效应，具备高频、高功率特性，在功率及微波领域均拥有巨大的需求潜力。根据Yole Development的研究预测，2022年GaN功率器件市场规模将达到4.5亿美元，2019至2022年的年复合增长率将高达91%；至2023年，GaN微波器件市场规模将达到13.2亿美元，2017至2023年的年复合增长率可达22.9%。

三、市场竞争格局

（一）MEMS业务：

MEMS芯片制造处于产业链的中游，该行业根据设计环节的需求开发各类MEMS芯片的工艺流程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮，MEMS芯片制造行业已形成较为稳定的市场竞争格局，意法半导体（STMicroelectronics）、TELEDYNE DALSA、瑞典Silix、台积电（TSMC）、索尼（SONY）、X-FAB长期保持在全球MEMS代工第一梯队，合计占据着超过65%的市场份额。截至目前，公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司在北京投资建的规模量产线“8英寸MEMS国际代工线”已投入运营，此外国内正在建设运营MEMS代工线的公司主要有上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、中芯集成电路制造(绍兴)有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司等。

（二）GaN业务：

第三代半导体材料及器件是全球战略竞争的新领域，美国、日本、欧洲正在积极进行战略部署，我国也正在积极推进。GaN业务是目前集成电路产业中不多的不存在显著代差的领域，且国内市场拥有巨大的需求及进口替代潜力。目前主要的GaN功率器件厂商有英飞凌（Infineon）、GaN systems、纳微（Navitas）、宜普（EPC）、德州仪器（TI）、Transphorm、Exagan等；主要的GaN微波器件厂商有科锐（Cree）、Qorvo、Macom、NXP、住友（Sumitomo）等；主要的外延材料厂商有日本住友、日本信越、富士电机、台湾汉磊等。截至目前，国内从事GaN外延材料以及功率、微波器件业务的厂商主要有苏州能讯高能半导体有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、英诺赛科(珠海)科技有限公司等。

四、公司行业地位

（一）MEMS业务

公司全资子公司瑞典Sillex是全球领先的纯MEMS代工企业，服务于全球各领域巨头厂商，且公司正在瑞典扩充产能，同时北京“8英寸MEMS国际代工线”已投入运营，有望继续保持纯MEMS代工的全球领先地位。根据世界权威半导体市场研究机构Yole Development的统计数据，2012年至今，瑞典Sillex在全球MEMS代工厂营收排名中一直位居前五，与意法半导体（STMicroelectronics）、TELEDYNE DALSA、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，2019及2020年在全球MEMS纯代工厂商中位居第一。随着公司境内外新增产线及产能的陆续建设及投入使用，公司将继续保持在全球MEMS产业竞争中的第一梯队。

（二）GaN业务

公司相关技术团队具备第三代半导体材料与器件，尤其是氮化镓（GaN）外延材料及器件的研发生产能力，在研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆方面具备业界领先水平，已陆续研发、推出不同规格的产品及应用方案，同时已与境内外产业链上下游公司达成良好合作，公司属于行业的新进入者和竞争者，正在积极把握住产业发展机遇、积累业务竞争要素、奠定自身的行业地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,239,642,304.26	4,775,820,168.84	51.59%	4,169,865,582.94
归属于上市公司股东的净资产	5,082,992,412.37	3,082,849,283.84	64.88%	2,808,843,986.79
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	928,547,013.90	765,006,087.93	21.38%	717,966,331.76
归属于上市公司股东的净利润	205,727,463.64	201,096,906.27	2.30%	115,438,474.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,856,216.12	5,570,164.14	543.72%	61,676,272.73
经营活动产生的现金流量净额	103,579,004.06	255,397,596.33	-59.44%	189,065,362.50
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.00%	0.18
加权平均净资产收益率	5.58%	6.83%	-1.25%	4.52%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	199,404,911.69	195,432,298.00	243,291,453.98	290,418,350.23
归属于上市公司股东的净利润	34,080,747.75	37,983,397.32	18,679,885.99	114,983,432.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,649.67	-5,908,241.70	-5,227,058.28	46,573,866.43
经营活动产生的现金流量净额	-44,453,247.41	-14,713,127.21	-44,402,502.96	207,147,881.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

上表中公司第三季度主要财务指标与公司已披露的《2021年第三季度报告》存在差异，此前已披露的2021年第三季度营

业收入为188,776,363.45元（经审计更正后产生的差异为54,515,090.53元）；归属于上市公司股东的净利润为15,484,513.97元（经审计更正后产生的差异为3,195,372.02元）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,986,735.25元（经审计更正后产生的差异为8,759,676.97元）；经营活动产生的现金流量净额为-76,286,908.43元（经审计更正后产生的差异为31,884,405.47元）。

该等差异产生的原因为公司管理层在《2021年第三季度报告》出具时点、公司聘请的年审会计师事务所在《2021年年度报告》出具时点对耐威时代100%股权交易事项中该子公司出表具体时间的判断出现差异。

1、股权交易背景

2021年3月16日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，同意将公司全资子公司耐威时代以37,350万元的价格转予青州市宏源公有资产经营有限公司（以下简称“青州宏源”），该事项经公司2020年年度股东大会审议通过。2021年6月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》，对股权转让交易条款作出调整，调整后的交易对价为18,121.71万元，该次交易事项调整已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、《2021年第三季度报告》出具时点

根据2021年6月的交易调整方案，耐威时代原持有的导航产业基地土地使用权、房屋、建筑物及构筑物等资产不再列入原协议项下股权转让标的范围内，而全部由公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公司承接。该等资产的转移程序涉及外部政府主管部门及单位的审批及操作，截至2021年9月底该等程序尚未完成，同时导致以此为前置程序的工商变更登记程序在2021年9月底也尚未完成。

公司于2021年9月底前合计收到股权转让款10,900.00万元（占总交易对价18,121.71万元的60.15%）。

在公司《2021年第三季度报告》出具时点，管理层基于《股权转让协议》中的过渡期损益安排条款、交易对方已支付股权受让款比例超过60%，同时基于股权转让交易中的资产转移程序及工商变更登记程序预计不存在办结障碍的合理预计，认定耐威时代自2021年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，并以此为基础核算并出具2021年第三季度财务数据。

3、《2021年年度报告》出具时点

公司聘请的年审会计师事务所在进行2021年年度审计时认为，截至2021年末耐威时代土地使用权、房屋、建筑物及构筑物等资产的转移程序仍在办理中，且未如预期完成该次股权转让交易的工商变更登记，且《股权转让协议》中约定了股权交割完成的条件，基于谨慎性原则考虑，认为该子公司截至2021年末仍应纳入公司合并报表范围。基于年审会计师事务所意见，为更准确地反映实际情况，公司依据企业会计准则及公司会计政策，对2021年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对2021年第三季度财务数据进行更正。

4、后续进展

2022年3月，该次股权转让交易中涉及的资产转移程序已全部办结，公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公司已取得相关资产证书；北京耐威时代科技有限公司已完成该次股权转让交易的工商变更登记程序并取得新的营业执照，自2022年第二季度开始不再纳入公司合并报表范围。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	27.84%	203,208,552	189,938,642	质押	134,940,014
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	12.10%	88,362,101	88,362,101		
中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+	国有法人	5.07%	37,000,000	0		
中金期货有限公司—中金期货—融汇 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.06%	7,748,934	7,748,934		
UBS AG	境外法人	0.88%	6,392,970	6,392,870		
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴乘风 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	6,199,147	6,199,147		
杭州乐信投资管理有限公司—乐信长阳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	5,927,934	5,927,934		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	5,064,300	0		
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	5,036,807	5,036,807		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	4,667,020	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18 号单一资产管理+之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、报告期内整体经营情况

报告期内，公司半导体业务继续快速发展且整体盈利良好，其中占比最高的MEMS业务整体业绩优良，瑞典FAB1&FAB2在新增产能磨合的同时仍通过优化业务结构实现了收入及盈利规模的连续增长；北京FAB3正式投入生产，虽然产生亏损，但在收入方面实现零的突破并努力推进产能及良率爬坡。GaN业务在上年低基数的情况下实现了高增速，但收入规模仍受限于合作代工产能瓶颈，业务潜力尚待释放。公司导航业务因其中重要子公司在报告期末尚未满足剥离出表条件，在报告期内仍贡献了一定比例的业务收入和利润，截至本报告披露日，该剥离事项已完成，预计导航业务在未来的收入贡献将大幅降低。另外，公司部分参股投资的公司业绩良好，贡献了一定的投资收益，投资参与的半导体产业基金、北斗产业基金处于回报期，持续贡献投资收益。

二、报告期内重要事项

（一）投融资事项

报告期内，为更好地服务于主业发展，公司根据长期发展战略继续积极开展投融资活动；与此同时，公司接近完成剥离原有航空电子、导航等非半导体业务，资源持续导向聚焦于战略性MEMS与GaN业务。MEMS方面，公司除继续支持瑞典FAB1&FAB2、北京FAB3扩充产能之外，于报告期内合计收购控股子公司瑞典Sillex少数股东合计持有的12.20%股权，于报告期末签约拟收购德国 Elmos位于德国北莱茵威斯特法伦州多特蒙德市的汽车芯片制造产线相关资产德国 FAB5。GaN方面，公司与潍坊市政府、聚能创芯共同投资设立聚能国际，以参股方式分期投资该本土GaN芯片制造产线。

其他产业投资方面，公司参与投资5家境内企业及1家产业投资基金。存量投资动态方面，公司继续取得投资收益；参股子公司聚能国际股权结构调整；参投公司光谷信息推进申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（截至本报告披露日已终止审核）；出售全资子公司耐威时代100%股权，对全资子公司中测耐威进行减资。

融资方面，公司完成向特定对象发行A股股票23.45亿元；推出2021年限制性股票激励计划；公司2021年新增银行授信2.8亿元。

（二）公司治理事项

1、补选董事

公司原第四届董事赵焯先生因个人原因辞去公司董事职务，2021年8月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议，经公司第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，公司董事会同意由张帅先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在获选后同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、补选监事

公司原任监事袁理先生因工作原因辞去公司监事职务，2021年12月14日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名闻静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案已经公司于2021年12月30日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

（三）重大业务事项

1、许可申请遭瑞典战略产品检验局ISP否决

2021年10月5日，公司收到控股子公司瑞典Silex管理层的通知，瑞典Silex已收到瑞典战略产品检验局（the Swedish Inspectorate of Strategic Products，简称为ISP）的正式决定并经瑞典Silex管理层与ISP现场会议确认，瑞典Silex于2020年11月向瑞典ISP提交的向公司控股子公司赛莱克斯北京出口与正式生产制造首批MEMS产品相关技术和产品的许可申请被瑞典ISP否决。

2、北京FAB3与客户签署《战略合作框架协议》

2021年8月13日，公司控股子公司赛莱克斯北京与武汉怡格敏思科技有限公司、武汉敏声新技术有限公司签署《战略合作框架协议》，鉴于在各自领域拥有的技术、资源优势，经过友好协商，决定在“射频滤波器芯片”的8英寸晶圆代工领域开展长期战略合作，将共同建设能够充分满足射频滤波器芯片产品代工制造需求的定制化专用产能，包括落实生产线所需设备清单和超净间装修布局。

（四）子公司其他事项

1、聚能创芯股权结构调整

2021年1月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，公司控股子公司聚能创芯股东袁理先生将其持有的聚能创芯23.75%股权（尚未实缴的认缴出资权）以0元价格转让给青岛聚贤汇能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚贤汇能”），公司放弃此次股权转让的优先购买权。2021年2月已完成工商变更登记。

2021年2月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，公司控股子公司聚能创芯股东青岛海丝以3,000万元的价格向西藏智通创业投资有限公司（以下简称“西藏智通”）转让其持有的聚能创芯6%股权（对应注册资本480万元）；青岛民芯以2,000万元的价格向西藏智通转让其持有的聚能创芯4%股权（对应注册资本320万元）；聚贤汇能以2,000万元的价格向吕天然转让其持有的聚能创芯4%股权（对应注册资本320万元），以500万元的价格向珠海睿瑶股权投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的聚能创芯1%股权（对应注册资本80万元）。公司放弃此次股权转让的优先购买权，持有聚能创芯股权的比例保持38.125%不变。2021年4月已完成工商变更登记。

2、为聚能国际代理采购

2021年8月9日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司为参股子公司代理采购暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司赛莱克斯北京与参股子公司聚能国际签署《代理采购合同》，由赛莱克斯北京为聚能国际代理采购第三代半导体6-8英寸成套工艺制造设备。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、为北京FAB3提供委托贷款

2021年8月9日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以自有资金通过银行向赛莱克斯北京提供不超过人民币2亿元委托贷款，贷款利率不低于公司同期相应融资利率、不高于同期银行贷款基准利率，委托贷款期限为3年。委托贷款利率及还款方式以最终签订的相关委托贷款合同为准。

4、聚能制造股权结构调整

2021年8月25日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司股权结构调整的议案》，公司全资子公司聚能海芯拟将其持有的聚能制造未实缴的100%认缴出资权以零对价转让给公司。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完成后，聚能海芯不再持有聚能制造股权，聚能制造将成为公司直接持股100%的子公司。

5、光谷信息表决权委托

2021年9月30日，公司与公司参股子公司光谷信息共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李焯、张文海签署《表决权委托协议》，将公司持有的光谷信息29.9952%股权对应的表决权全部委托给光谷信息上述共同实际控制人行使。本次表决权委托不会导致公司合并报表范围的变化，光谷信息仍为公司参股子公司。

二、报告期内期后事项

1、与合肥高新区签署《合作框架协议》

2022年1月1日，公司与合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《合作框架协议》，拟在合肥高新区投资建设12吋MEMS制造线项目，旨在充分利用当地优势资源要素，尤其是集成电路产业链及下游应用产业优势，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺晶圆代工业务的进一步发展。

2、出售中科昊芯股权

2022年1月11日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司转让参股子公司股权的议案》，公司全资子公司微芯科技拟将其持有的中科昊芯22.6597%股权以61,900,941元的价格转让给顶芯未来（海南）科技中心（有限合伙）。本次交易完成后，中科昊芯不再是公司参股子公司，2022年2月，本次转让已完成工商变更登记。

3、2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成

2022年1月26日，公司完成2021年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作。

4、与北京怀柔经信局签署《合作协议》

2022年1月29日，公司控股子公司海创微芯与北京市怀柔区经济和信息化局（以下简称“怀柔经信局”）签署了《合作协议》，拟在怀柔区投资建设并运营6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台、先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心、8英寸晶圆级封装测试规模量产线。

5、2019年非公开发行股份上市流通

公司2019年2月12日在深圳证券交易所上市的非公开发行股份于2022年2月14日上市流通。

6、2021年向特定对象发行股份上市流通

公司2021年9月8日在深圳证券交易所上市的向特定对象发行的股份于2022年3月8日上市流通。